

Compression Molding System

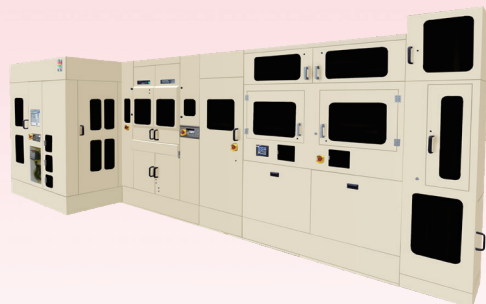
Model CPM1300



**Compression molding system
for expanded super large size PLP**

适用范围扩大的超大尺寸PLP成形用压缩成形设备

- 扩大可支持尺寸，实现最大715mm×715mm超大面板的自动成型
- 采用最合适的成形技术进行大型面板级封装
- 应用Cavity Down构造实现超大尺寸panel的高品质化
- 通过颗粒树脂的均匀分撒来实现成型品质的安定化
- 可通过增设或减少模组的方式灵活应对产能变化



SPECIFICATION

Items		Unit	Description			
机型		—	CPM1300			
设备区分		—	Manual	Semi-Auto	Full-Auto	
面板·晶圆类型		—	面板			
面板尺寸		mm	□700 (Max.)			
树脂		—	颗粒			
机械时间		sec	—	—	Approximately 75	
外形尺寸	模组数量	module	1	1	1	2
	宽度	mm	2,550	5,075	6,258	8,008
	纵深	mm	2,895	2,895	3,850	3,850
	高度	mm	2,445	2,445	2,445	2,445
重量		ton	15.2	21.6	26.1	41.3
每模成形面板数量		workpiece	1	1	1	2
料盒放置空间		—	—	—	FOUP Input/Output stage : 1 cassette each In/Out stage : Panel 1 by 1	
合模压力		kN/(tf)	49.0—2,940/5.0—300.0			
合模速度		mm/sec	47 (Max.)			
品种切换方式		—	—	采用KIT更换方式		
使用分离膜的宽度		mm	840 (Max.)			

- 以上数据为本公司标准机型时的规格
- 以上规格根据实际需要有可能变更
- 如有其他特殊规格要求，另行协商



[东和半导体设备（上海）有限公司]

中国上海市普陀区凯旋北路1188号环球港B座20A

TEL 021-6888-6860

[Overseas Sales Contacts]

■ Japan / Headquarters

- TOWA Corporation

■ China

- TOWA (Shanghai) Co., Ltd.
- Hechuang Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd.
- TOWA Taiwan Co., Ltd.

■ Korea

- TOWA Korea Co., Ltd.

■ Singapore

- TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.

■ Malaysia

- TOWA Malaysia Sales & Services Sdn. Bhd.

■ Thailand

- TOWA THAI COMPANY LIMITED

■ Philippines

- TOWA Semiconductor Equipment Philippines Corp.

■ India

- TOWA SEMICONDUCTOR INDIA PRIVATE LIMITED

■ Germany

- TOWA Europe GmbH

■ Netherlands

- TOWA Europe B.V.

■ the United States

- TOWA USA Corporation



[Website]

[Inquiry contact]

TOWA (本公司商标),  是TOWA株式会社的商标或注册商标。

20260201-001-HQ